

黃大益(David Huang) ，

高雄中山大學機械系與 EMBA 畢業，

證照

SSBB(六標準差黑帶)、PMP(國際專案管理師)、CQM(品質管理師)與 ISO 9001 主導稽核員證照。

資歷

大慶汽車(Subaru)品管工程師

達潤工業建廠工程師與品保主管

日月光材料廠建廠主管

美商 Culligan 在台品質代表

台泥南科能元電池廠廠長

京鼎(半導體設備廠)品保協理

溢泰(國際知名 OEM 大廠)品質主管

長期擔任企業內部講師(曾榮獲日月光 2004 年度最佳講師)，分享工作累積的知識與智慧結晶，並擔任製程品質改善 team leader。

以下是針對中興大學精密工程研究所碩士博士班的介紹腳本，詳細闡述書的核心概念、與精密工程領域的連結、實戰工具應用，以及對學生未來職涯的啟發。

這本書的核心是「價值資訊模型」：每一筆中性資料 (Data) 進來後，會經過你的認知濾鏡 (過往經驗 + 人心邊界 + 康德先驗形式)、轉化六因素 (提供方、載體、傳遞、處理、噪音防止、接收方)，以及時間維度 (及時 vs. 延遲、顯性 vs. 隱性、系統 vs. 假性)，最終決定它變成正面價值 (及時優勢、延遲護城河、系統複利)，還是負面雪球 (隱負 N²燒億、假性正面腐敗)。

我用「18 類價值資訊矩陣」把這 18 種路徑清楚分類，讓你一眼就能判斷：

「這筆資料最後會幫我賺錢，還是讓我燒錢？」再搭配一套實戰工具鏈：

- 溝通 6R (Right Person/Time/Info/Format/Attitude/Feedback)：防資訊不對等與傳遞斷層
- 風險 5R 框架 (Recognize/Rate/Respond/Review/Refine)：量化隱負風險、及早圍堵

- P10 根因圍堵（從 P1-P5 救火到 P6-P10 永絕後患與知識沉澱）
- PLAS 點線面立體溝通：從細節點擴到系統面、跨領域立體預測
- MKSPAPC 成長螺旋：個人與系統的持續迭代（Mindset → Knowledge → Skill → Professional → Attitude → Performance → Cycle）
- VE-SWOT、價值曲線圖：預測延遲效應與長期護城河

這些工具直接對應精密工程領域的真實挑戰：

- 在光學、MEMS、奈米加工、精密量測中，微小變異（溫度、振動、材料應力）怎麼從顯性及時負面，延遲滾成系統崩潰？用 18 類矩陣 + 風險 5R 可以提前抓到隱負。
- 跨領域團隊協作（光電 + 機械 + 控制 + 材料 + 自動化）時，實驗數據、模擬結果、供應商回饋怎麼因為資訊不對等導致斷層？溝通 6R + PLAS 就是專門解決這個。
- 客訴或製程良率悄悄下滑時，怎麼從中性輸入轉成可行動的決策優勢？價值資訊閉環 + P10 根因圍堵，讓你不只修問題，還沉澱成組織 DNA。
- 未來進入半導體、光電、精密製造業，你會面對 VUCA/BANI 的混沌世界：AI 趨勢、深度偽造、供應鏈彈性需求放大風險。這本書幫你從「技術高手」升級到「系統價值創造者」——不只會做精密元件，還能讓價值資訊自我改善、放大複利，從燒悔轉躺賺。

書中也融入 DIKW 階層、變異理論、結果偏誤與事後諸葛防範、MBTI 人格濾鏡等，讓你從工程思維擴展到認知革命層級。最終目標很簡單：讓你在資訊洪水中，不再被淹沒，而是把洪水變成水力發電動能，建構屬於自己的永續護城河。

如果正在做跨領域整合研究、精密製程優化、智慧製造相關題目的同學，或未來想進台積電、聯發科、光寶、帆宣、精材等產業，我書本的內容可以幫大家提前避開職場常見的坑、提早建系統優勢。